

(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(51) Int. Cl.⁵
H01L 23/495

(11) 공개번호 특1994-0022819
(43) 공개일자 1994년10월21일

(21) 출원번호	특1994-0006324
(22) 출원일자	1994년03월29일
(30) 우선권주장	040,236 1993년03월30일 미국(US)
(71) 출원인	아메리칸 텔리폰 앤드 텔레그라프 캠페니 마가레트 에이.버키
	미국, 뉴욕 10013-2412, 뉴욕, 애비뉴 오브 디 아메리카즈 32
(72) 발명자	앨버트 마이클 벤조니
	미국, 펜실베이니아 18087, 니하이 카운티, 로우워 메쿤지 타운쉽
(74) 대리인	이병호, 최달용

심사청구 : 없음

(54) 성형 패키지 배열용 리드프레임 구조체

요약

성형 패키지와 함께 사용하기 위해 제안된 리드프레임 구조체가 설명되었다. 특히, 상기 구조체는 와이어 본드 부착 위치가 성형 물질을 통해 노출되는 배열에 적합하다. 가끔 종래의 성형 공정은 노출된 와이어 본드 위치상에 성형 물질이 잔여물을 남기게 되는 결과를 초래한다. 본 발명은 리드프레임 도금 작업이 진행되는 동안 와이어 본드 위치상에 보호층 물질을 포함하도록 지시한다. 그때 상기 보호층은 성형 작업후 부식액을 사용하여 제거되며, 기초 순수 와이어 본드 접촉위치가 노출된다.

대표도

도3

명세서

[발명의 명칭]

성형 패키지 배열용 리드프레임 구조체

[도면의 간단한 설명]

제3도는 본 발명의 도금된 리드프레임 구조를 설명하는 도면, 제4도는 보호층의 제거로 이어지는 성형 DIP 패키지의 단면도.

본 건은 요부공개 건이므로 전문 내용을 수록하지 않았음

(57) 청구의 범위

청구항 1

와이어 본드 설정을 위한 다수의 위치와; 다수의 와이어 본드 위치를 피막시키기 위해 배열된 접촉 물질과; 연속 성형 작업이 진행되는 동안 접촉 물질을 보전할 수 있도록 접촉 물질을 피막시키기 위해 배열된 보호 물질을 포함하는 것을 특징으로 하는 리드프레임 구조체.

청구항 2

제1항에 있어서, 상기 리드프레임은 니켈 도금된 구리 리드프레임을 포함하는 것을 특징으로 하는 리드프레임 구조체.

청구항 3

1항에 있어서, 상기 접촉 물질은 금을 포함하는 것을 특징으로 하는 리드프레임 구조체.

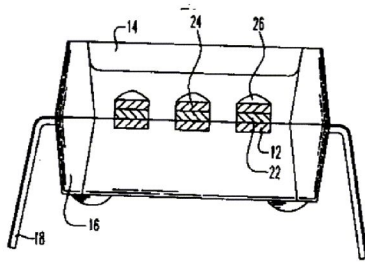
청구항 4

1항에 있어서, 상기 보호 물질은 구리를 포함하는 것을 특징으로 하는 리드프레임 구조체.

※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.

도면

도면3



도면4

